

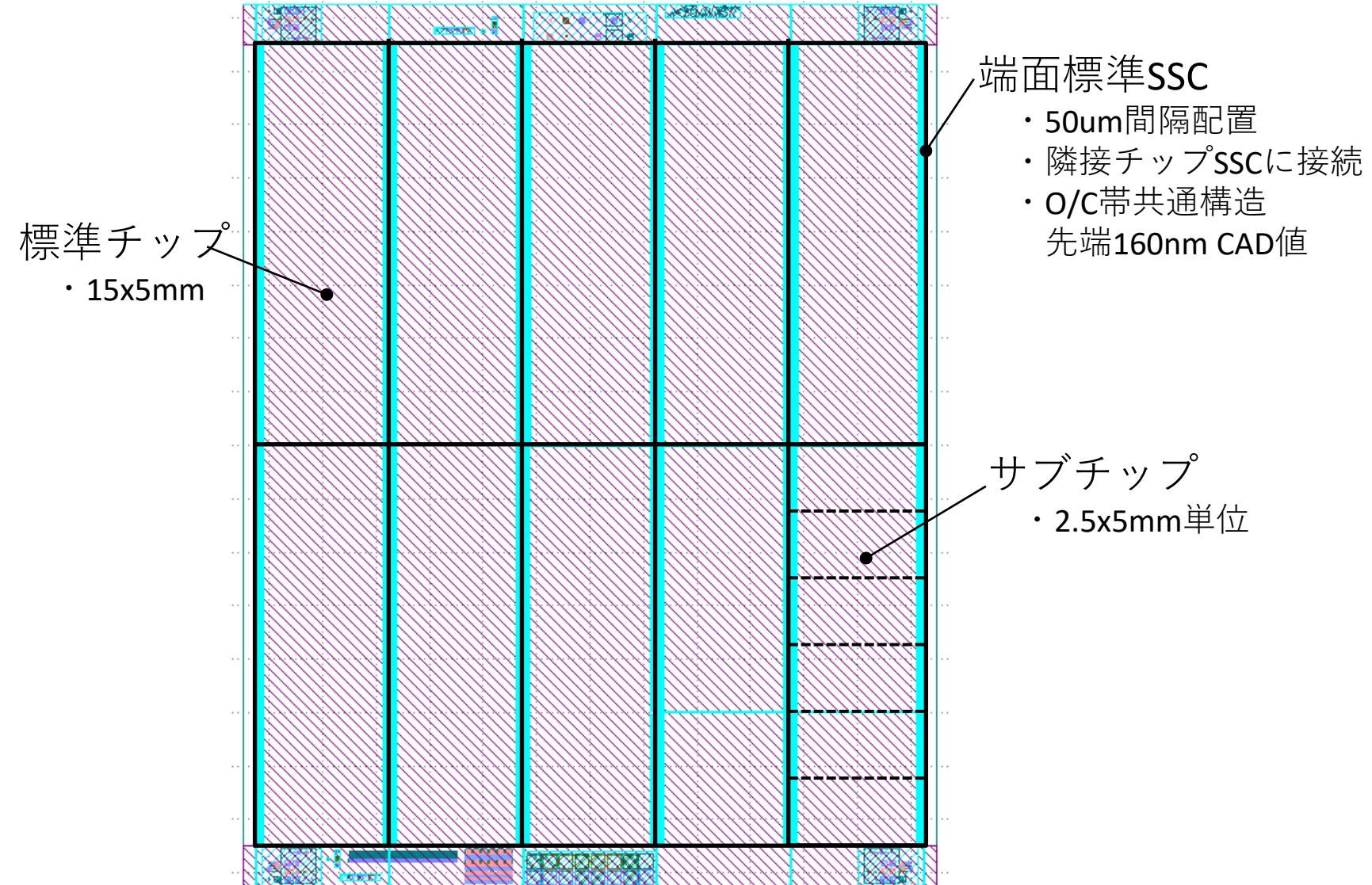
産総研シリコンフォトニクス用MPW 標準チップ[®]

(MPW_Cell_5x**.gds)

産業技術総合研究所
光電融合研究センター

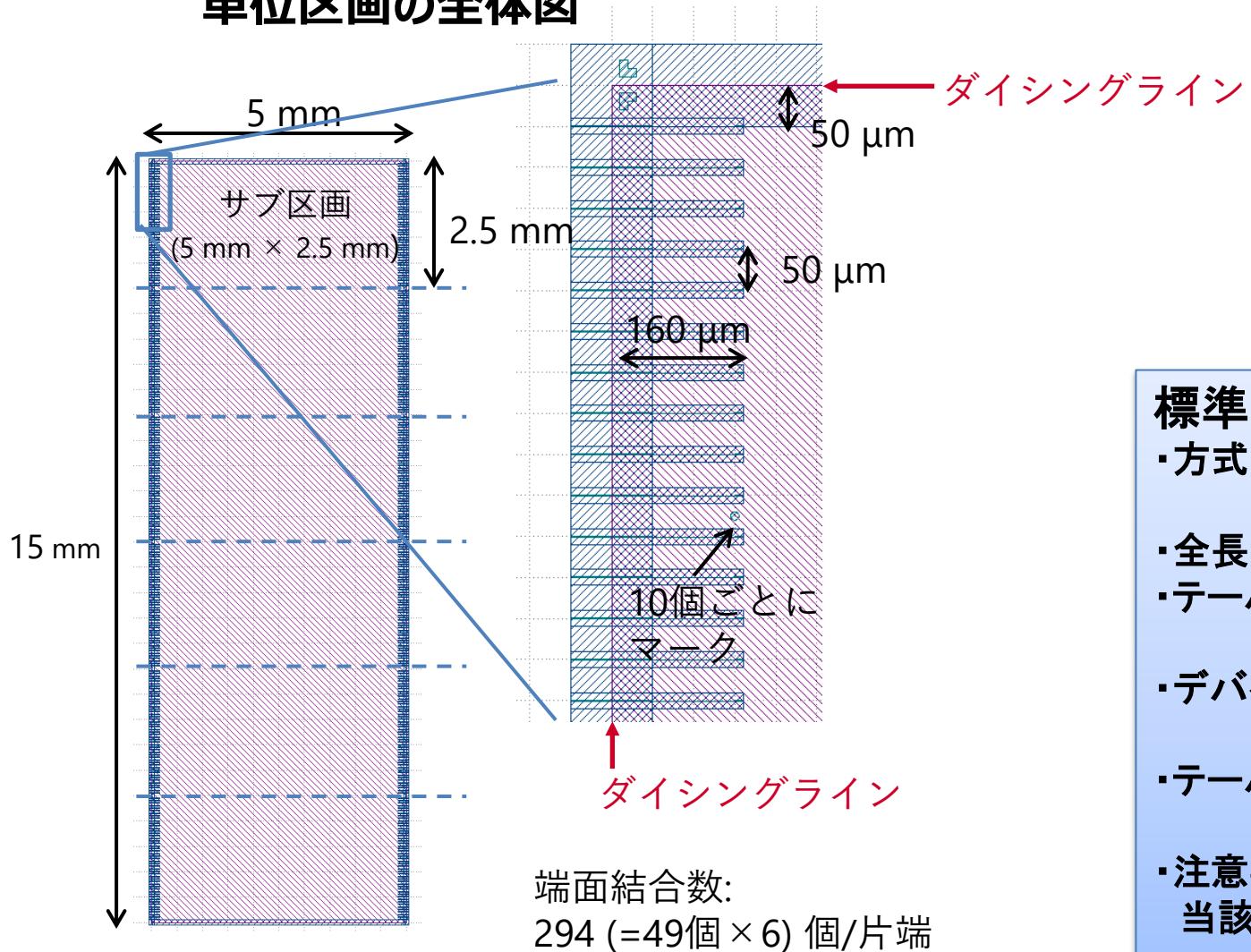
2025/11/12

標準チップ配置

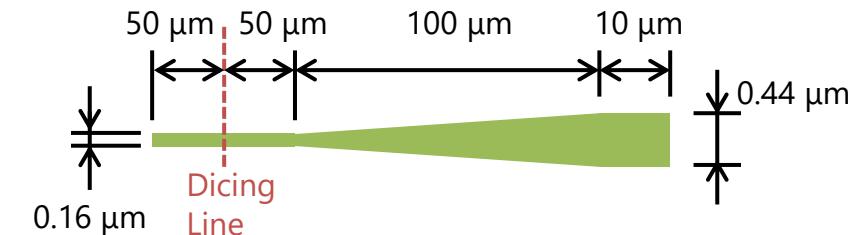


標準チップ構成 (MPW_Cell_5x**.gds)

単位区画の全体図



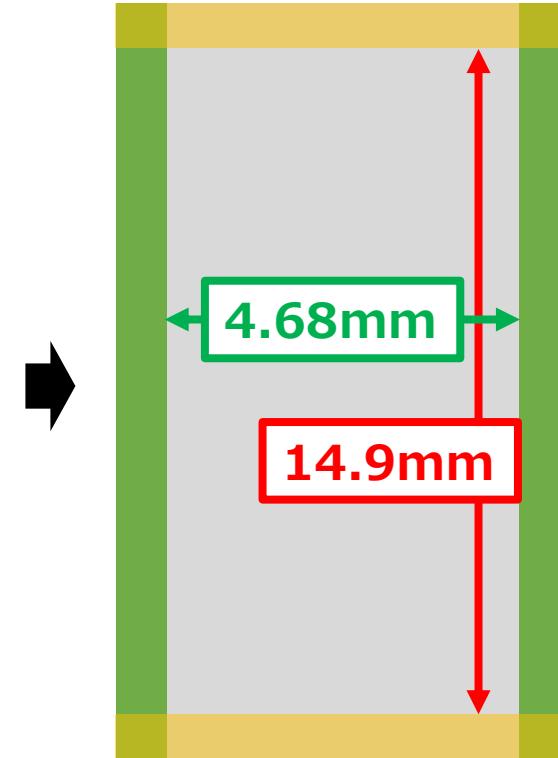
標準端面ファイバ結合構造



標準端面ファイバ結合の概要

- ・方式: 単純逆テーパー O帯C帯共通
- ・全長: 160 μm
- ・テーパー先端: 幅 0.16 μm (CAD値)
長さ 50 μm
- ・デバイス接続導波路: 幅 0.44 μm (CAD値)
長さ 10 μm
- ・テーパー長: 100 μm
- ・注意事項: 当該構造(全長160 μm)の修正や削除はできない

標準チップ規定領域



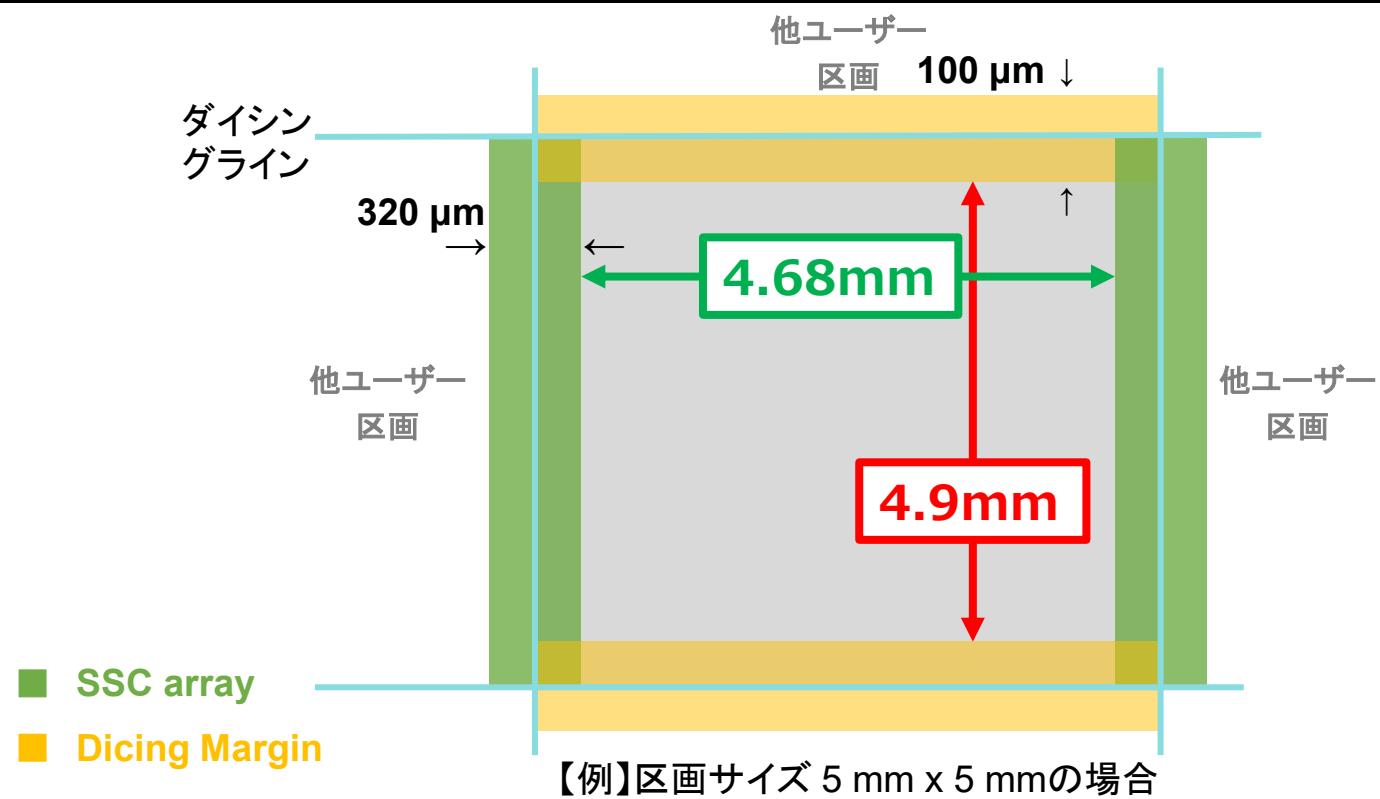
SSC および ダイシングマージンは
レイヤー53にて指定 (変更不可)

区画内左右 160 μm: 標準端面ファイバ結合構造
(ダイシングマージン含む) 変更不可※

区画内上下 50 μm : ダイシングマージン 仕上がり保証外

※契約時の事前調整により、変更を許容する場合があります

機密性2情報／配布禁止、転送禁止



区画サイズ	自由描画エリア
5 mm x 15 mm(標準)	4.68 mm x 14.9 mm
5 mm x 10 mm(サブ)	4.68 mm x 9.9 mm
5 mm x 5 mm(サブ)	4.68 mm x 4.9 mm
5 mm x 2.5 mm(サブ)	4.68 mm x 2.4 mm